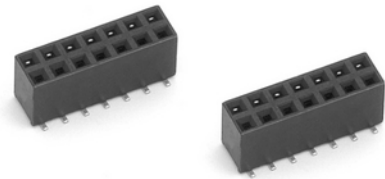


SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend, 2-reihig - BH 4,5mm SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical, Double Row - 4.5mm Profile

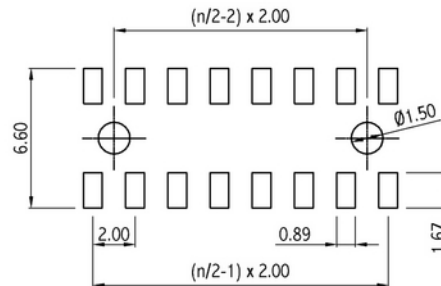
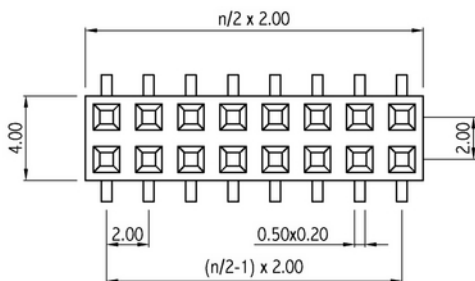
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +105°C
Temperature Range	-55°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering

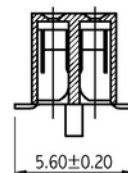
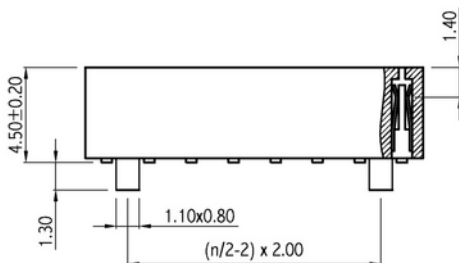


© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.
Dual beam contacts accept 0.50mm square pins.



PCB Layout



Series	Contacts*	Plating	Locating Pegs*	Packaging*
7460	026	00	00	PPTR
	04-80 Zweireihig Double row	00 Vergoldet Gold plated	00 Ohne Pos.hilfen W/o loc. pegs 10 Mit Pos.hilfen With loc. pegs	ST PPST PPTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / In tubes w/o Pick&Place-Pad
PPST In Stangen mit P&P-Pad / In tubes with P&P-Pad
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pad / Tape & Reel with P&P-Pad

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

